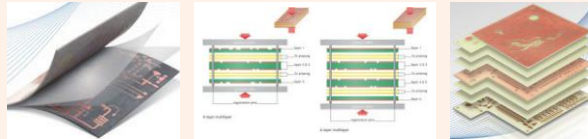


다층기판 제작기 | MultiPress S

| 제품 특징 |

- PCB 다층 회로 적층 가능
- 균일한 재료 접착을 위해 정밀 온도 및 압력 공정 제어로 균등한 압력 분배
- 특수 공정 프로파일을 통해 RF 재료의 안전한 접합



제품 규격	
최대 layout 크기(X/Y)	200mm x 275mm
Laminating영역 (X/Y)	229mm x 305mm
최대 적층 압력	286 N/cm ² at 229 x 305mm
최대 적층 온도	250 °C (480 °F)
최대 적층	8층
다층기판 공정 시간	약 90분
마이크로 프로세서 제어	압력/온도/시간 프로파일
전원	220V, 60Hz, 2.8kW
장비 크기 (W x H x D)	600mm x 620mm x 530mm
유입장치 크기 (W x H x D)	260mm x 410mm x 280mm
무게	170kg